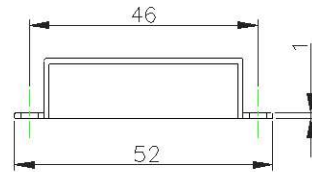
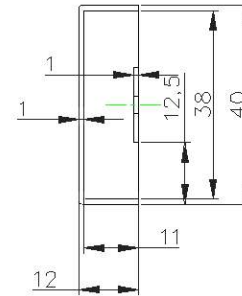
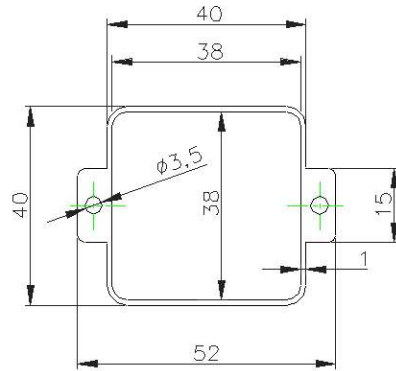


Modul- Gehäuseoberteil



Modul- Gehäuseoberteil schwarz.  
 Modul- Gehäuseoberteil mit offenem Boden.  
 Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen  
 der Platine mit Gießharz verschlossen.

[Verwendungsbereich] G059 Modul-Gehäuse mit Befestigungsloschen		[Zul. Abw.]	[Oberfl.]	Maßstab 1:1	[Gewicht]
				[Werkstoff, Halbzeug] Thermoplast	
				[Modell- oder Gesenk-Nr]	
		Datum	Name	MODUL-GEHÄUSE	
		Bearb	25.04.05 M.SIMON		
		Gepr.			
		Norm			
				G059	
Zust	Änderung	Datum	Name	Ersatz für:	Ersatz durch:
			KEMO-Electronic GmbH		